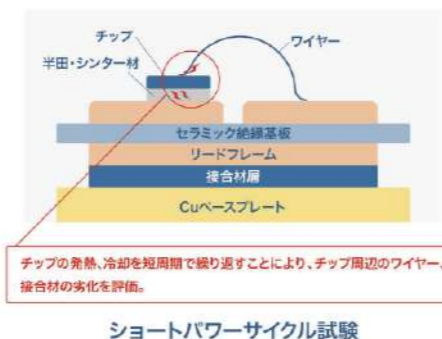
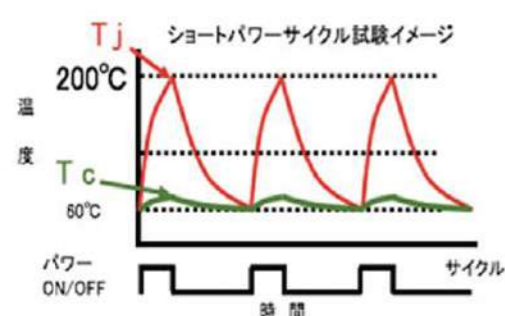
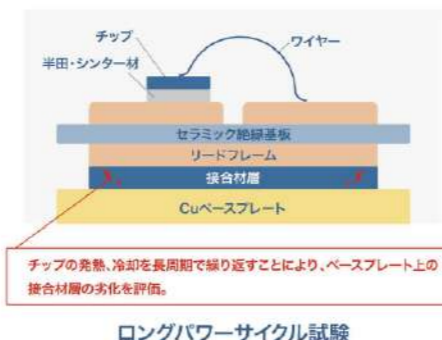
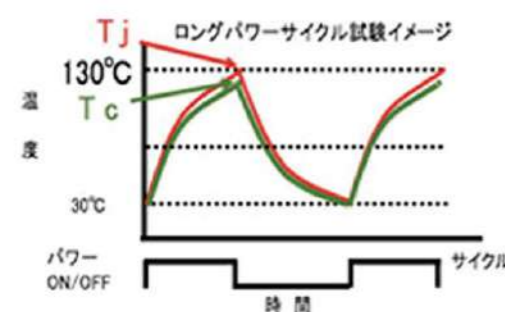


パワーサイクル試験装置 断続通電試験装置・連続通電試験装置

短周期試験



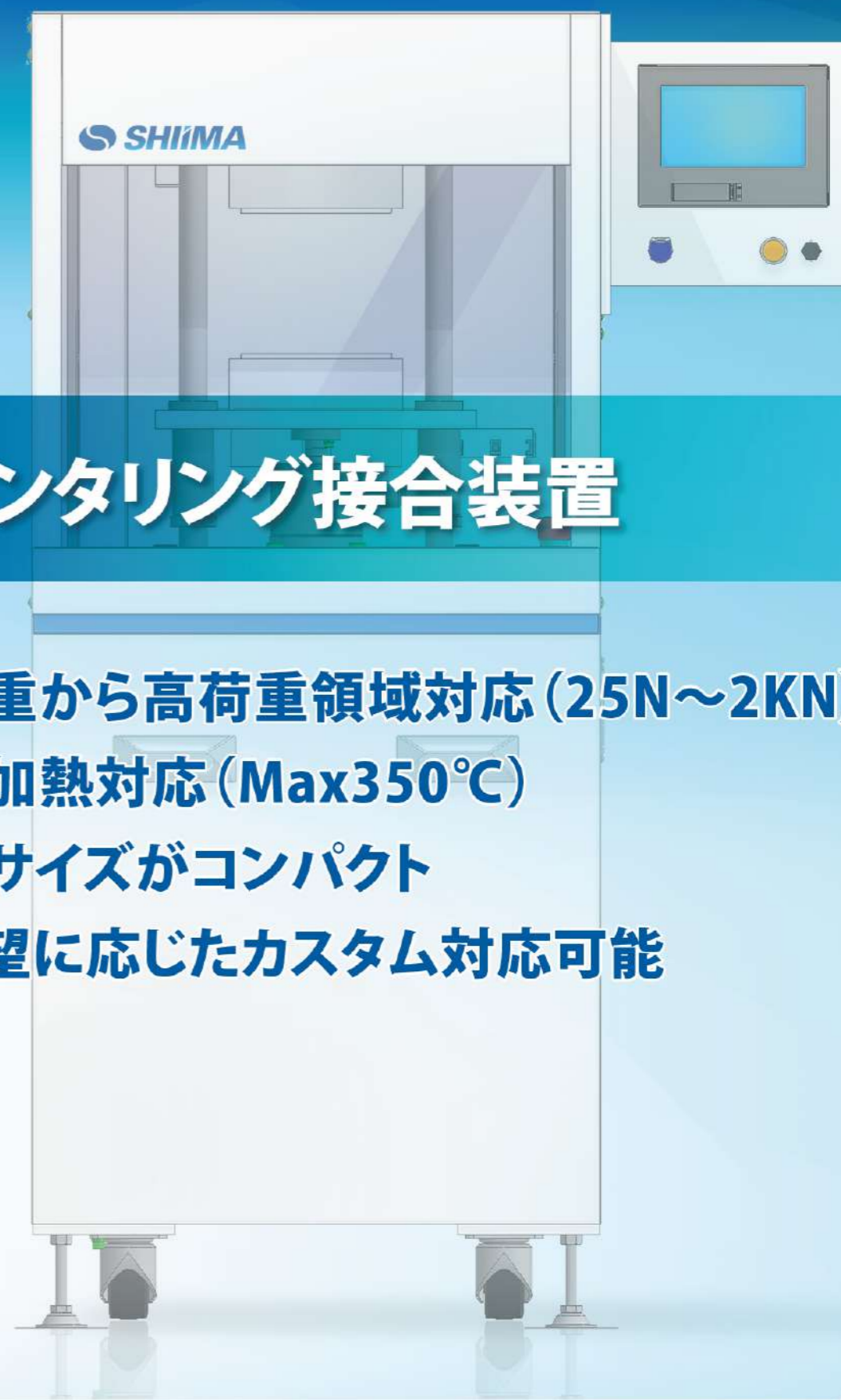
長周期試験



シンタリング接合装置

- 低荷重から高荷重領域対応 (25N~2KN)
- 高温加熱対応 (Max350°C)
- 装置サイズがコンパクト
- ご希望に応じたカスタム対応可能

- ご希望に応じたカスタム対応可能
- 試験サンプル毎にゲート調整が可能
- Max18個の測定が可能
- ダイオード交互測定モード対応!



パワーサイクル試験装置

チップ温度を上下させた際の局所発熱に対する熱疲労の寿命を推定します。水冷式を採用しており、安定した放熱特性のもと試験の実施が可能です。尚、**ご要求事項へのカスタマイズ対応が可能です。**

測定項目

- パワーサイクル試験（短周期、長周期）
- 連続通電試験
- Kファクター
- 熱抵抗測定（構造関数）

特長

- 試験サンプル毎にゲート調整が可能であり、複数サンプルの同時試験が可能
- 3系統の電源があり1系統あたりMax6個の測定が可能
→Max18個の測定が可能
- ダイオード交互測定モード対応
- ゲート電圧の印可範囲が広い：-9~20V
- 400mm×400mmコールドプレートの温度設定領域が広い

装置仕様詳細

項目	詳細	
対象デバイス	Diode / IGBT / MOS FET	
測定モード	Diode: A-K（交互測定モード対応） MOS FET, IGBT: D-S / Body Diode	
加熱用電源：3台	最大電圧	30V/台
	最大電流	300A/台
測定用電源：3台	最大電圧	30V/台
	最大電流	2A/台
計測	サンプリング周期	1 μ S (最小)
	分解能	0.3mV
ゲート電圧	印加電圧	-9V~20V
	分解能	0.1V
温度測定用熱電対	18CH	
冷却機構	温調プレート	水冷式×2
	設定温度	15°C~120°C（チラー・温調器）
	流量	7L/min（最大）
試験可能デバイス数	最大6個直列×3 = 18個	
構造関数解析	専用アプリケーション（開発中） ※不良箇所を推定	

シンタリング接合装置

～装置販売および加工受託サービス～

当装置は、当社長年のパワー半導体試作組立や材料開発サポートで得た経験を基に、研究者及び開発者向けパワー半導体用接合材料（シンタリング材）の加熱及び加圧用途として開発をいたしました。

加工のみの作業も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

使用用途

- パワー半導体モジュール実装開発
- パワー半導体向け焼結接合材料開発 など

特徴

- 低荷重から高荷重領域対応
- 高温加熱対応
- 装置サイズがコンパクト
- N2対応

装置仕様詳細

ステージサイズ	160×160mm
加熱温度	RT～350℃（コンスタントヒート）
プレス圧力	25N～2KN
表示部	タッチパネル
装置寸法	W933mm×D1092mm×H1494mm
装置重量	約400kg
電源電圧	3相 AC200V, 50A